

免責事項

本プレゼンテーション資料には、株式会社堀場製作所の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競争状況、為替レートなどの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

Explore the future

utomotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientifi

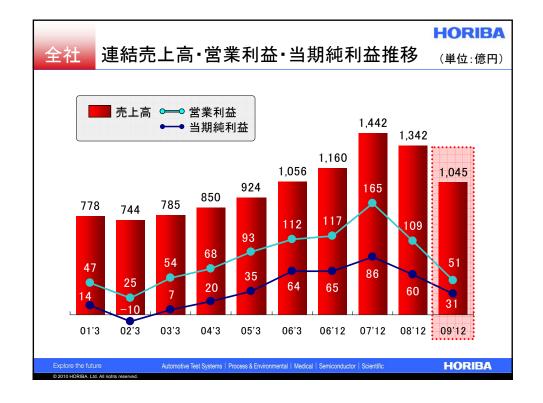
説明内容

HORIBA

- · 2009年12月期 決算概要
- · 2010年12月期 業績計画
- ・セグメント別詳細説明
- · 2010年12月期 上期業績計画
- ・経営上の取組事項

Explore the future

tomotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific



2009年12月期 連結決算概要

第3四半期末から回復基調も、全体として減収減益



- ・自動車/分析/半導体で需要大幅減、医用好調で採算性も改善
- ・為替影響(対日本円)により、売上高▲93億円、営業利益▲11億円
- たな卸資産評価減、減損損失などにより特別損益尻悪化▲8億円

売上高 ▲22%、営業利益 ▲53%、当期純利益 ▲48%

B/S

- ・売上債権減少▲28億円、固定資産増加+9億円
- ・借入金減少▲26億円

バランスシートのスリム化推進 総資産▲36億円



- ・運転資本圧縮などで営業CF +137億円
- ・設備投資などにより投資CF ▲41億円
- ・借入金返済・配当支払などで財務CF ▲47億円

手元流動性の確保で、金融危機に対応 現預金 +49億円

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA

2009年12月期 通期連結実績

HORIBA

(単位:億円)

	2008年	2009年		
	実績	実績	前年比	前回予想
売 上 高	1,342	1,045	▲297 (▲22.1%)	1,040
営業利益	109	51	▲ 58 (▲ 53.1%)	28
営業利益率	8.2%	4.9%	▲ 3.3P	2.7%
経常利益	100	52	▲47 (▲ 47.5%)	26
当期純利益	60	31	▲28 (▲ 47.6%)	14
ROE	7.7%	4.0%	▲ 3.7P	1.8%

© 2010 HORIBA, Ltd. All rights reserve

motive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA 2009年12月期 セグメント別通期実績 (単位:億円)						
【前年比】						
		売上高		営業利益		
	2008年 実績	2009年 実績	前年比	2008年 実績	2009年 実績	前年比
自動車	542	371	▲31.4%	72	18	▲ 75.0%
分 析	385	325	▲15.6%	18	15	▲16.8%
医用	247	223	▲9.6%	6	19	+182.1%
半導体	167	124	▲25.5%	12	▲0	-
合 計	1,342	1,045	▲22.1%	109	51	▲53.1%
Explore the future © 2010 HORIBA Ltd. All rights reserved.	Automotive Test Sy	stems Process & Environ	mental Medical S	Semiconductor Scientific	Н	ORIBA

HORIBA 2009年12月期 セグメント別通期実績 (単位:億円)						
【前回予想比】						
	売上高	営業利益	要因分析			
自動車	▲ 8	+3	DTS事業にて10億円の売上未 期末での排ガス事業の採算改			
分 析	+0	+9	ホリバ・ジョバンイボン社の収益	E性向上		
医用	▲ 1	+4	利益率の高い新製品貢献 米国・中国事業の収益性改善			
半導体	+14	+7	シリコン半導体向け回復・LED 販売価格下落で利益率回復は			
合 計	+5	+23				
Explore the future © 2010 HORIBA Ltd. All rights reserved.	Automotive Tes	t Systems Process & E	invironmental Medical Semiconductor Scientific	HORIBA		

業績回復へ向けた施策

前年比30億円の経費削減を年初に計画

- 削減実績(前年比)
 - 1Q:14億円 → 上期:20億円 → 3Q(累計):37億円 → <u>通期:40億円</u>
- 通期削減実績内訳([]は年初計画値)
 - ◇人件費:<u>17億円</u>〔10億円〕
 - ◇その他、経費: 23億円[20億円、うち国内14億円、海外6億円]

2010年の計画

- 2009年比で25億円経費増加
 - ◇人件費+10億円
 - ◇その他経費+15億円(売上増に伴う販売費増加)
 - 支出引き締めは維持
- 研究開発費 98億円 → 100億円(+2億円)
 - 新製品投入へ向けた積極投資継続

Explore the futu

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA

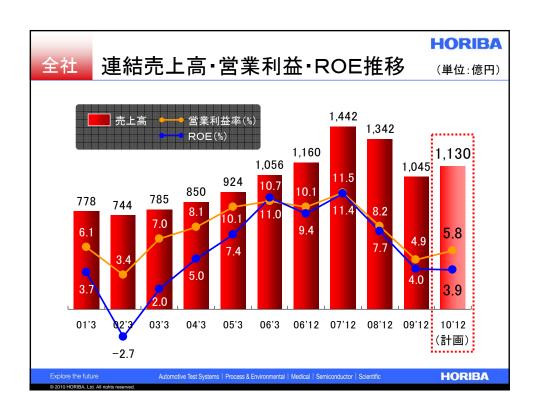
説明内容

HORIBA

- · 2009年12月期 決算概要
- ·2010年12月期 業績計画
- ・セグメント別詳細説明
- · 2010年12月期 上期業績計画
- ・経営上の取組事項

Explore the future

omotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific



				HORIBA		
2010年12月期 連結業績通期計画 (単位:億円)						
	2008年	2009年	2010	年		
	実績	実績	計画	前年比増減		
売 上 高	1,342	1,045	1,130	+ 84 (+ 8.1%)		
営業利益	109	51	65	+ 13 (+ 26.4%)		
営業利益率	8.2%	4.9%	5.8%	+ 0.9P		
経常利益	100	52	55	+ 2 (+ 4.3%)		
当期純利益	60	31	32	+ 0 (+ 1.2%)		
ROE	7.7%	4.0%	3.9%	▲ 0.1P		
2010年想定レート US\$=90円 EUR=130円 2009年度実績レート US\$=93.65円 EUR=130.35円 円高の影響→1円につき、ドル8,100万円、ユーロ1,400万円 営業減益						
Explore the future		Process & Environmental Medical	Semiconductor Scientific	HORIBA		

2010年12月期 セグメント別業績計画

(単位:億円)

【前年比】

	売上高			営業利益		
	2009年 実績	2010年 計画	前年比	2009年 実績	2010年 計画	前年比
自動車	371	370	▲0.5%	18	10	▲44.8%
分 析	325	350	+7.6%	15	15	▲1.3%
医用	223	240	+7.4%	19	21	+9.8%
半導体	124	170	+36.2%	▲ 0	19	-
合計	1,045	1,130	+8.1%	51	65	+26.4%

© 2010 HORIBA. Ltd. All rights reserved.

utomotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA

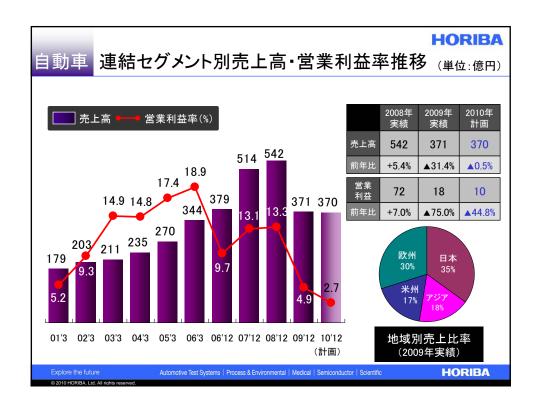
説明内容

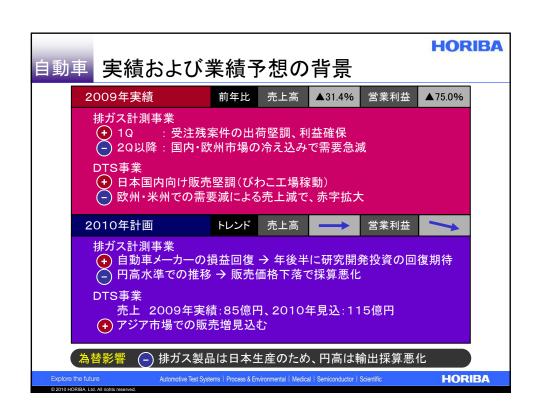
HORIBA

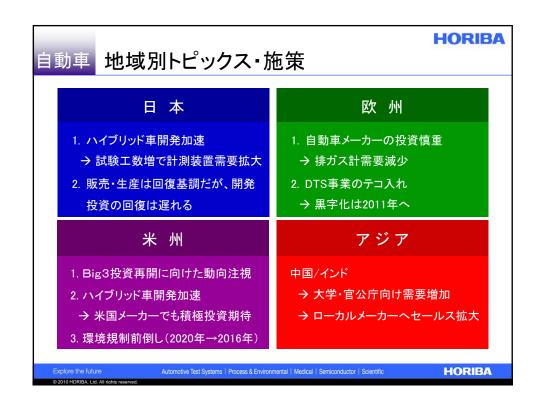
- · 2009年12月期 決算概要
- · 2010年12月期 業績計画
- ・セグメント別詳細説明
- · 2010年12月期 上期業績計画
- ・経営上の取組事項

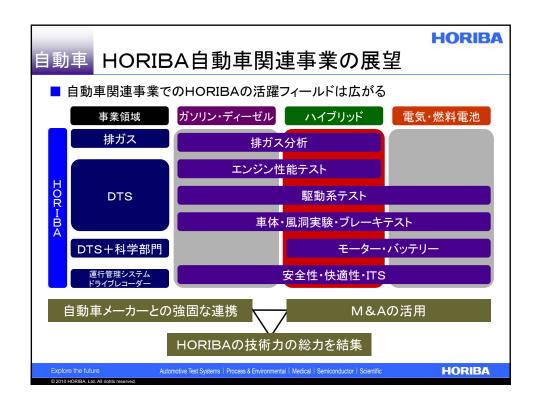
© 2010 HORIBA, Ltd. All rights reserve

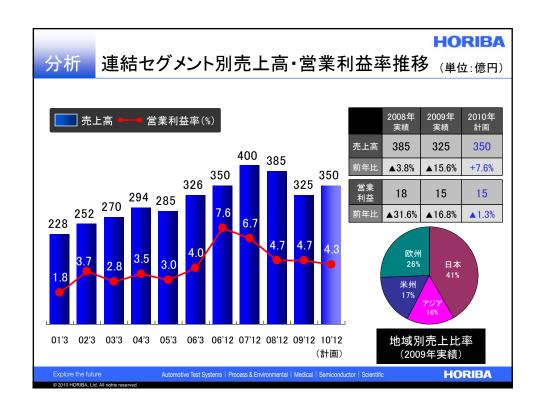
omotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientifi

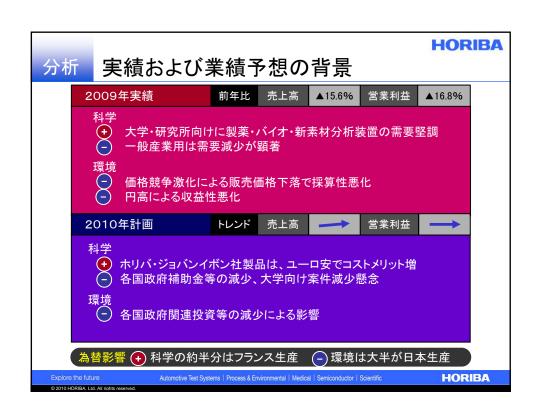




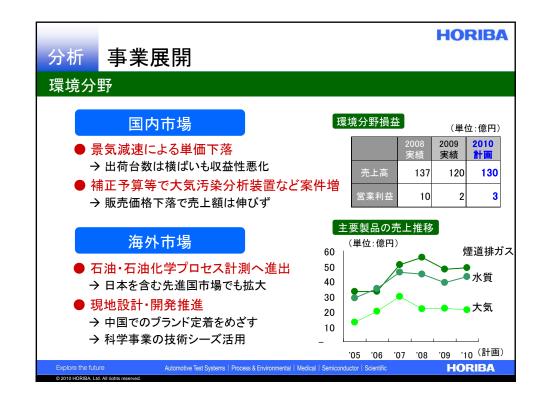


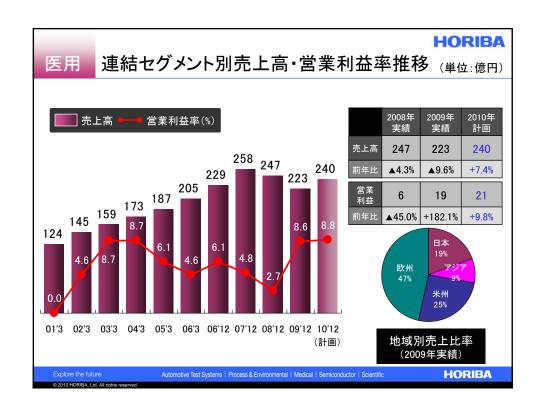


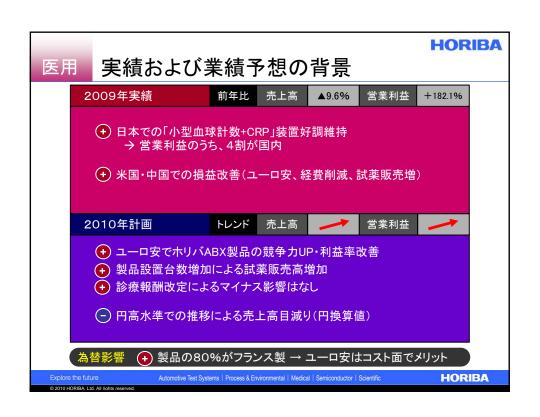


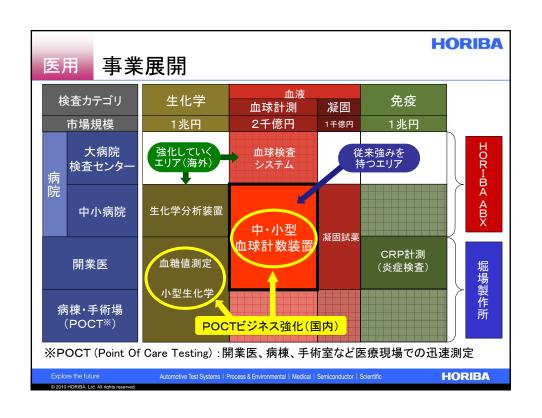


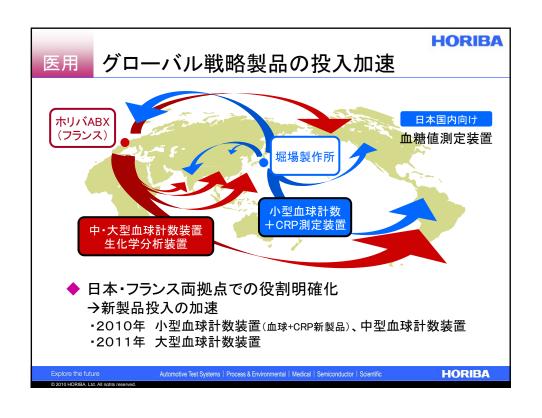
HORIBA 分析 事業展開 科学分野 科学分野損益 顧客・市場別の状況 (単位:億円) 2009 2010 ●先端市場向け 実績 ・学術関連のサポート強化 248 205 220 → 大学・政府予算、補助金案件の獲得 8 12 12 ▲一般産業向け ・円高による海外向け製品の競争力低下 主要製品の売上推移 → 堀場製作所製品の採算悪化 (単位:億円) 50 ●中国市場:堅調 40 ・ホリバ・ジョバンイボン社製品堅調 Grating 30 ・政府が先端技術への投資を開始 蛍光 20 ● 粒度分布 • 新規制動向注視 10 X線 '05 '06 '07 '08 '09 '10(計画) **HORIBA**

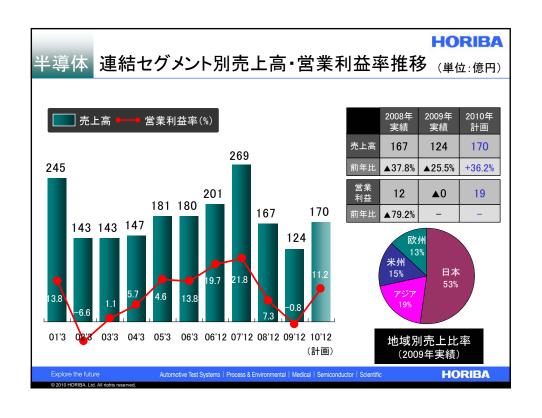


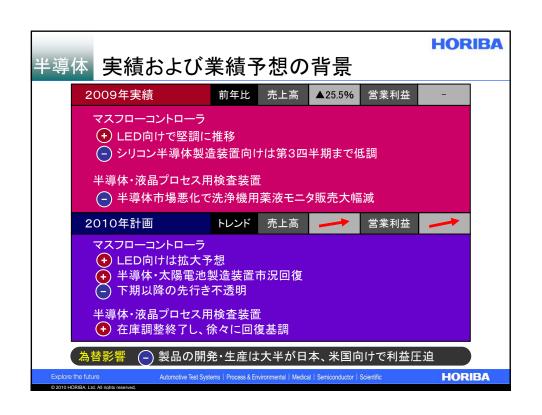


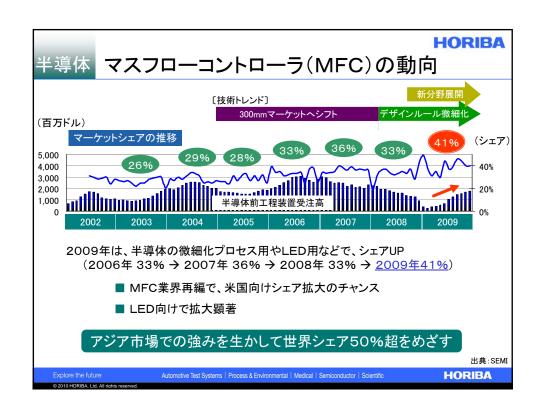


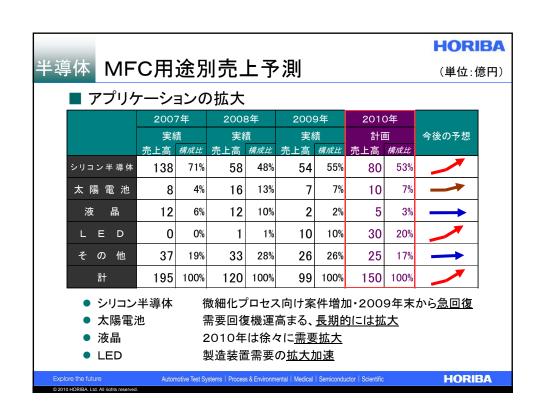












半導体 分野別HORIBA製品対応度

■ 各アプリケーションと主要製品のマトリックス

<u> </u>						
製品群アプリケーション	薬液濃度 モニタ	薄膜検査	異物検査	MFC	強み	
シリコン半導体	•••	• •	• •	•••	微細化プロセス用でフルラインアップ	
太陽電池	•	• • •	-		結晶系から薄膜系までカバー 薄膜検査装置で市場拡大予想	
液晶	•	• • •	•	• •	台湾メーカーを中心に高シェア	
L E D	1	1	1	• • •	欧州/日本で高シェア獲得	

- (「●」が多い製品・アプリケーションほど、ラインアップ充実・もしくは高シェア)
- ◆バランスの良い製品展開
 - マスフローコントローラと薬液モニタで高シェア
 - シリコン・液晶で培った顧客ネットワークを太陽電池・LED市場へ → シリコンサイクルの影響を低減

HORIBA

説明内容

- **HORIBA**
- · 2009年12月期 決算概要
- · 2010年12月期 業績計画
- ・セグメント別詳細説明
- ·2010年12月期 上期業績計画
- ・経営上の取組事項

HORIBA 2010年【第1四半期・上期】連結業績計画 (単位:億円) 1Q 2Q 2009年 上期 通期 下期 売 上 高 235 490 555 254 1.045 営業利益 20 **4** 16 35 51 経常利益 18 **1** 17 35 52 当期純利益 9 10 21 0 31 1Q 2Q 上期 下期 通期 2010年 売 上 高 264 276 540 590 1,130 営業利益 9 13 22 43 65 経常利益 38 11 17 55 6 2 当期純利益 23 7 9 32 HORIBA

説明内容

HORIBA

- · 2009年12月期 決算概要
- · 2010年12月期 業績計画
- ・セグメント別詳細説明
- · 2010年12月期 上期業績計画
- ・経営上の取組事項

© 2010 HORIBA, Ltd. All rights reserved

omotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientifi

「One Company 経営」の推進

HORIBA Group is One Company

HORIBAグループは、統一されたブランドの下、 ビジョン・戦略を共有し、One Companyとして、 グループの企業価値・利益最大化を追求する

くこれまでの施策 >

- 社名変更・ブランドの統一
- マトリックス経営の導入
- 米国/欧州グループ会社再編
- シェアドサービス拡大(米国・日本)

Explore the future

tomotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA

© 2010 HORIBA, Ltd. All rights reserve

ヨーロッパに開発センター新設

HORIBA

パリ近郊に研究開発センターを新設

- パリ近郊「サクレークラスター」に、日本企業で初めて進出
 - ・光学分析企業の集積地形成を目的とする国家プロジェクト
 - ・ダノン社(食品)、EDF社(フランス電力公社)、タレス社(国防関連)等も進出
 - ・エコール・ポリテクニーク(フランス高等技術学校)隣接
 - → 産官学の交流により研究開発の促進をめざす

ヨーロッパにおけるホリバグループの中心拠点として活用

- ・2009年 パリで発表会見
- ・2011年 稼動予定 (順次、周辺の拠点を移転)



© 2010 HORIBA, Ltd. All rights reserved

motive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientif

HORIBA 配当政策および今期の配当金について 配当政策 ● 配当金 = 個別(単体)純利益 X 30% ※個別純利益にはグループ会社の前期利益からの配当が含まれる ● 残りは戦略的投資資金として内部留保(設備投資・M&A等) 配当額 ● 業績悪化に加え、前期減益でグループ会社からの配当金減少 13円(中間 6円、期末 7円) → 2009年12月期配当 → 2010年12月期配当予想 15円(中間 6円、期末 9円) (単位:円) 10年間の配当推移 40 30 2010年予想:15円 20 10 2009年実績:13円 0 **HORIBA**

